

东芯半导体股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于 2025 年 4 月 23 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年（以下简称“报告期”），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取得了良好的效果，现将行动方案 2025 年半年度执行情况评估如下：

一、聚焦公司主业，优化业务布局

2025 年上半年，公司继续深耕存储芯片主业，主动适应不断变化的经营环境，持续加大技术和产品研发的投入。同时公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。公司高度重视自主知识产权的保护，秉承长期主义理念，坚持技术创新，致力于持续为企业、行业及社会创造更大价值。

（一）深耕主营业务，坚持技术创新

报告期内，公司继续加强在 SLC NAND Flash 行业的技术领先优势，积极推进存储产品的升级迭代。报告期内“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。2xnm 制程 SLC NAND Flash 产品系列研发持续推进，进一步提升了可靠性指标，并持续扩充产品料号。

公司持续推进 48nm、55nm 制程下 64Mb-2Gb 中高容量的 NOR Flash 产品的研发，围绕可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子、端侧 AI 等应用领域，精确定位不同容量的客户需求，优化性能、功耗与性价比的合理匹配。随着产品迭代升级，公司不断丰富 NOR Flash 产品矩阵，进一步强化了在高可靠性场景下的解决方案能力。

公司在已量产的 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2、LPDDR4x、PSRAM 等产品基础上，继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，目前主要围绕可穿戴，

网络通信等应用领域，公司将持续拓宽 DRAM 产品线，完善产品布局，把握市场份额增长机遇。

公司目前已可以向客户提供 4Gb+2Gb、4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 等多种组合的 MCP 产品，主要应用于 5G 通讯模块、车载模块、工业控制等应用领域。公司在研产品进一步拓展多容量配置，依托自主研发 SLC NAND Flash 与 DRAM 组合，打造具备成本优势与稳定性能的 MCP 解决方案，持续丰富产品线，全面满足客户的多样化需求。

公司继续推进车规级存储产品的研发及产业化进度，着力构建高附加值的车规产品矩阵，公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 的验证，具备满足严苛车规级应用环境的能力。公司稳步推动车规客户的导入与销售，已经完成国内多家整车厂的白名单导入并且持续推动多家海内外一级汽车供应商（Tier1）的供应商资质认证，并在多款车型中实现量产。公司产品在汽车电子中的应用领域包括通信及远程控制系统、ADAS 系统、智能座舱域控系统、车身控制系统等。

（二）围绕存储主业，优化业务布局

报告期内，公司持续推进“存、算、联”一体化战略布局，通过技术创新、生态协同与产业链延伸，逐步构建起以存储芯片为核心，覆盖计算、通信领域的多元化技术生态体系，旨在建立一体化的生态发展体系，为未来增长注入新动能。

在联接芯片领域，公司正持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计工作。基于对市场趋势的研判，公司发现 Wi-Fi 芯片市场蕴含显著增长潜力，尤其是 Wi-Fi 6/7 技术在高带宽传输、高安全性保障、超低延迟响应及多设备并发接入场景中展现的核心优势，使其成为驱动该市场未来增长的关键技术方向。随着智能手机、笔记本电脑、物联网（IoT）终端、智能家电等联网设备规模的持续扩大，市场对 Wi-Fi 芯片组的需求呈现确定性增长态势，同时对无线连接的可靠性与传输速率提出更高要求。公司首款无线传输芯片定位于高带宽、低延迟应用场景，可满足智能终端领域对高速无线连接的技术需求。通过差异化技术创新，公司致力于为客户提供本土化的智能无线通信与感知芯片及系统级解决方案。目前该产品研发项目进展符合预期。

在计算芯片领域，公司于 2024 年通过自有资金 2 亿元人民币战略投资上海

砺算，布局高性能 GPU 赛道。上海砺算主要从事多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和 AI 加速，对标主流 GPU 架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整 GPU 架构自主可控的关键问题。报告期内，上海砺算完成首款自研 GPU 芯片“7G100”的首次流片、晶圆制造及芯片封装，对产品的测试结果符合预期，目前正按计划进行客户送样以及量产工作。产品可应用于个人电脑、专业设计、AI PC、云游戏、云渲染、数字孪生等应用场景。

（三）保持高水平研发投入，坚持核心技术自主可控

报告期内，公司研发费用 1.05 亿元，占当期营业收入的 30.74%，金额同比持平。报告期内，获得发明专利授权 8 项（其中中国发明专利 2 项，美国发明专利 3 项，韩国发明专利 3 项）；申请集成电路布图设计权 5 项；申请注册商标 8 项。截至报告期末，公司拥有境内外有效专利 121 项、软件著作权 15 项、集成电路布图设计权 86 项、注册商标 14 项。截至报告期末，公司累计申请境内外专利 191 项，获得专利授权 121 项，专利涉及 NAND、NOR、DRAM 等存储芯片的设计核心环节，公司技术实力不断提升。

（四）稳步推动募投项目

公司持续强化募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，科学合理使用募集资金，切实保证募投项目顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，进一步丰富公司产品种类、提升产品性能，持续强化公司的创新能力，增强公司整体盈利能力。

报告期内“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售。该募投项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件并予以结项。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了包括股东会、董事会和管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权责明确、运作规范的公司治理体系。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办

法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《东芯半导体股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《市值管理制度》等30部公司治理制度进行了制定、修订。

报告期内，公司重视董事、监事、高级管理人员等“关键少数人员”的培训工作，借助证监会、上海市证监局、上交所、中国上市公司协会、上海上市公司协会等监管部门及平台的学习资源，组织相关人员积极参加各类培训，加强证券市场相关法律法规的学习，不断强化合规意识，提升公司董监高履职能力，推动公司持续规范运作。

三、加强投资者沟通，提升信息披露质量

公司常态化、高效地组织定期报告业绩说明会，在保障“关键少数”人员的高参与度和回复率的同时，向投资者全面介绍公司业绩，并积极回复投资者的问题。报告期内，公司于2025年5月13日在上海证券交易所上证路演中心举办了“东芯股份2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，并组织、参加了路演、反路演、策略会等共计约76场投资者交流会，并通过股东会、上证e互动、公司网站投资者关系专栏、投资者电话与电子邮箱等各种多样化方式和渠道开展投资者沟通与交流活动，保障投资者对公司信息的全方面了解，引导投资者更好理解公司的投资价值，增强投资者对公司的信心，并认真听取投资者对公司的意见和建议，助力公司高质量发展。公司借助新媒体，从多角度向投资者传递公司文化、产品、技术、业绩等方面的信息，报告期内公司微信公众号“东芯半导体”总计发布约29篇推文，粉丝总数超过13000人。

报告期内，公司积极践行可持续发展理念，重视ESG（环境、社会责任、公司治理）对企业的重要作用，积极将ESG理念和要求融入商业模式和管理体系，注重环境保护，积极履行企业社会责任。报告期内，公司披露了2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，对公司在上述责任领域的实践与绩效进行了汇报与总结，详见公司2025年4月23日披露的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

四、完善投资者回报机制，提升投资者信心

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，在注重生产经营的同时，重视广大投资者的回报，通过多种方式维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。

公司积极引导控股股东增持公司股份，认真履行市值管理主体责任，维护市场稳定。基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，公司控股股东东方恒信集团有限公司于 2024 年 10 月推出增持东芯股份的计划，拟自 2024 年 10 月 21 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份总金额不低于人民币 2.0 亿元。截至 2025 年 1 月 27 日，控股股东已完成本次增持计划，自 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 1 月 24 日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 8,411,537 股，占公司总股本 1.9020%，增持金额合计人民币 219,923,992.47 元（不含交易费用）。

五、重视人才培养，健全长效激励机制

公司坚持“人才优先，服务发展，使用为本”的核心理念，系统构建涵盖人才开发、评价选拔、流动配置与激励保障于一体的培训管理体系。依托科学的培训效果评估机制与高效反馈通道，确保培训成果精准支撑公司战略目标与业务发展需求，持续强化区域人才竞争优势。实施分层分类的精细化培训策略，着力打造结构合理、素质优良的高质量人才梯队。针对新员工，设置实战导向的项目演练，加速文化融入与岗位胜任；面向技术骨干，紧扣市场变化与行业前沿，量身定制核心技术人才培养路径。通过系统技能培训、专题研修及专家“传帮带”等多元模式，全面提升员工专业技术水平、职业认同与责任意识，夯实人才储备基础。报告期内，公司累计组织培训 25 场，参与培训总人次达 126 人，培训覆盖广、成效显著，有效支撑组织可持续发展。

公司持续完善激励与约束机制，优化薪酬体系，健全绩效考核制度，构建长效激励机制，充分调动管理层和核心业务（技术）骨干的积极性，增强组织凝聚力，推动公司健康、可持续发展。为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引并保留优秀人才，有效统一股东、公司与核心团队的长期利益，公司自 2022 年起已连续三年实施股权激励计划。公司为上述股权激励计划设置了公司层面及个人层面的双重考核机制。公司以营业收入增长率作为公司层面的业绩考核要求，激励对象须同时满足个人年度绩效考核要求，方可归属相应权益。该考核体系强

化了激励的约束功能，有效提升核心团队积极性与责任感，激发企业活力，助力战略目标实现，持续增强股东回报。报告期内，公司有序推进股权激励实施工作，启动了2023年股权激励计划首次授予部分第二个归属期以及2024年股权激励计划首次授予部分第一个归属期的股权归属工作，并于2025年7月9日完成了本批次股权归属的股份登记手续。

六、其他事宜

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。未来，公司将继续积极推动并落实2025年度“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提升盈利能力、提高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025年8月23日